

本文为企业价值系列之

二【盈利能力】篇，共选取11家半导体材料企业作为研究样本。

盈利能力评价指标有净资产收益率

、总资产收益率、毛利率以及净利率，并以近五年经营数据作为参考。数据基于历史，不代表未来趋势；仅供静态分析，不构成投资建议。

从近五年净资产收益率来看，

中晶科技、立昂微、神工股份、江丰电子、康强电子等5家企业超过10%，其中中晶科技平均净资产收益率19.67%。

中晶科技目前的主要产品为半导体硅材料

及其制品，产品涵盖半导体晶棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等。

半导体单晶硅片为最主要收入来源，收入占比64.47%，毛利率49.58%；半导体单晶硅棒、半导体功率芯片及器件收入占比达到10%。

从近五年总资产收益率来看，

神工股份、中晶科技等两家企业超过10%，其中神工股份平均总资产收益率13.49%。

神工股份主要产品为大直径单晶硅材料、硅零部件、大尺寸硅片。

大直径硅材料为最主要收入来源，收入占比95.79%，毛利率65.47%；硅零部件及其他收入占比不足2%。

从近五年毛利率来看，神工股份、中晶科技、立昂微、天岳先进等4家企业超过30%，其中立昂微平均毛利率40.10%。

立昂微主要产品有6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET芯片、6英寸砷化镓微波射频芯片。

半导体硅片为最主要收入来源，收入占比57.40%，毛利率45.45%；半导体功率器件收入占比接近40%；化合物半导体射频芯片收入占比不足2%。

从近五年净利率来看，神工股份、中晶科技、立昂微、清溢光电、雅克科技等5家企业超过10%，其中清溢光电平均净利率12.83%。

清溢光电主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等。

石英掩膜版为最主要收入来源，收入占比81.23%，毛利率21.86%；苏打掩膜版收入占比不足15%。

半导体材料企业盈利能力

注：

盈利能力榜单中，各项指标按照10/11的比例换算得出，综合指数为各项指标的平均值。如某个指标有数值，但没有指数（即表格为空格），则该指标权重会下降。